

中華民國專利公報 (19)(12)

(11)公告編號：143165

(44)中華民國79年(1990)10月01日

發明

(51)Int.Cl.: H05K

全 2 頁

(54)名稱：屏蔽板

(21)申請案號：77103323 (22)申請日期：中華民國77年(1988)05月19日

(72)發明人：雷斯利T·克拉克 英國

(71)申請人：皮爾京頓股份有限公司 英國

(74)代理人：蔡坤財 先生

1

2

[57]申請專利範圍：

1. 一種半透明電磁屏蔽板，組合上包括：

一在其主要表面上設置有一銀層之第一片玻璃或塑膠，該銀層厚至30nm；

一在其主要表面上設置有一銀層之第二片玻璃或塑膠，該銀層厚至30nm；

該第一及第二片以相對間隔關係擺置；

及第一及第二電接裝置與各別設在第一片及第二片上之銀層周圍，用以提供該銀層電接到地。

2. 如申請專利範圍第1項所述之板，其中，二片由其間之一中間層疊合一起。

3. 如申請專利範圍第2項所述之板，其中，該中間層小於0.8mm厚。

4. 如申請專利範圍第2項所述之板，其中，該中間層厚度係介於0.8mm與11mm之間。

5. 如申請專利範圍第2項所述之板，其中，該每一片設置有面對該中間層之銀層。

6. 如申請專利範圍第5項所述之板，其中，該中間層厚度小於0.8mm。

7. 如申請專利範圍第5項所述之板，其中，該中間層厚度介於0.8mm與11mm之間。

8. 如申請專利範圍第1項所述之板，其中，各銀層係夾設於兩反射層之間。

9. 如申請專利範圍第2項所述之板，其中，

10.

15.

20.

25.

各銀層夾設於反反射層間。

10. 如申請專利範圍第5項所述之板，其中，和銀層夾設於兩反反射層間。

11. 如申請專利範圍第1項所述之板，其中，各銀層之厚至10nm。

12. 如申請專利範圍第1項所述之板，其中，各第一及第二接裝置係與各別設在第一及第二片上銀層之全部周圍區相接觸。

13. 一種半透明電磁屏蔽板，組合上包含：
一在其主要表面設明一銀層之第一片玻璃或塑膠，該銀層厚至30nm，及該銀層係夾置於兩反反射層間；

一在其主要表面設有一銀層之第二片玻璃或塑膠，該銀層厚至30nm，及該銀層係夾置於兩反反射層間；

該第一及第二片以相對間隔關係設置；及

第一及第二電接裝置與各別設在第一及第二片上之銀層周圍接觸，用以提供銀層電接至地。

14. 一種半透明電磁屏蔽板，組合上包括：
一在其主要表面設明一銀層之第一片玻璃或塑膠，該銀層厚至30nm，及該銀層係夾置於兩反反射層間；

一在其主要表面設有一銀層之第二片

玻璃或塑膠，該銀層厚至30nm，及該銀層係夾置於兩反反射層間；

該第一及第二片以相對間隔關係設置其間並具有一空間；及

第一及第二電接裝置與各別設在第一及第二片上之銀層周圍接觸，用以提供銀層電接至地。

15. 一種半透明電磁屏蔽板，組合上包括：

一在其主要表面設明一銀層之第一片
玻璃或塑膠，該銀層厚至30nm，及該銀層

係夾置於兩反反射層間；

一在其主要表面設明一銀層之第二片
玻璃或塑膠，該銀層厚至30nm，及該銀層
係夾置於兩反反射層間；

5. 該第一及第二片以相對間隔關係藉介
於第一及第二片之中間層疊合在一起；及

第一及第二電接裝置與各別設在第一
及第二片上之銀層周圍接觸，用以提供銀
層電接至地。